

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 98 (1980)
Heft: 13

Artikel: Flachpilzdecken: Dimensionierung, Bemessung und Konstruktion
Autor: Egli, Hans B.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-74075>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Flachpilzdecken

Dimensionierung, Bemessung und Konstruktion

Von Hans B. Egli, Bern

2,5 zu statisch ausgeglichenen und wirtschaftlich günstigen Konstruktionen führt.

Die Biegemomente von Pilzdecken mit flachen rechteckigen Pilzen können mit dem «Nähungsverfahren für Flachpilzdecken» [1] bestimmt werden. Im folgenden werden Erfahrungen der Praxis mitgeteilt und Angaben gemacht für die Dimensionierung, Bemessung und Konstruktion von Flachpilzdecken [2].

Bezeichnungen

L_y	Spannweite in der Tragrichtung
L_x	Spannweite quer zur Tragrichtung
D	Dicke des Pilzes
d	Dicke der Platte

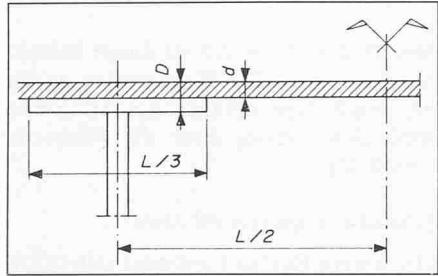


Bild 1. Verwendete Bezeichnungen

Dimensionierung

Die Dicken einer mehrfeldrigen Flachpilzdecke mit gleichmäßig verteilten Lasten können mit den folgenden empirischen Formeln abgeschätzt werden. Zuerst ist die Dicke einer statisch gleichwertigen Flachdecke ohne Pilzkopfverstärkungen zu bestimmen

$$\text{aus } t = \sqrt{\frac{P}{75}} \text{ [cm]}$$

mit $P = q \cdot L_x \cdot L_y$ [kg] und $q = (g + p)$ der Flachdecke [kg/m^2]

Diese Formel ist in Tabelle 1 ausgewertet für verschiedene Spannweiten $L_m = L_x \cdot L_y$ und für verschiedene Auflasten p .

Daraus ergeben sich die Dimensionen der Flachpilzdecke zu

$$d \approx 0,5 \cdot t \geq 14 \text{ cm}$$

$$D \approx (1,05 \div 1,25) \cdot t$$

Diese Dimensionen gelten in Innenfeldern wie in Randfeldern von Flachpilzdecken mit mehr als zwei Spannweiten

in jeder Richtung und mit $L_y/L_x \approx 0,7 \div 1,4$.

Die definitive Plattendicke d muss unter Umständen vergrössert werden wegen

- den langen Endfeldern,
- den hohen Nutzlasten als Wechsellaisten,
- den Einzellasten,
- den schwingenden Lasten,
- den erhöhten Ansprüchen an die Schallisolation und
- den ästhetischen Ansprüchen.

Die Wahl der endgültigen Pilzdicke D richtet sich nach dem gewünschten Ausnutzungsgrad des Betonquerschnittes im Stützenbereich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Verhältnis $D/d \approx 2,1 \div$

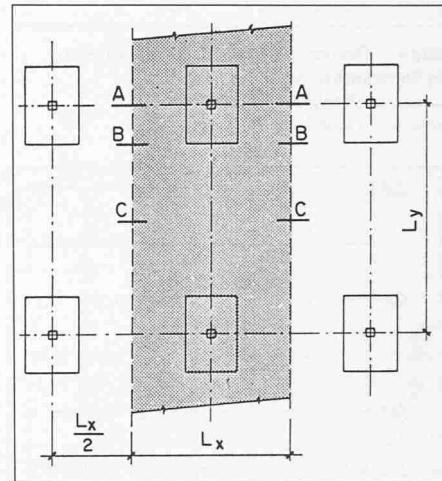


Bild 2. Verlauf der Biegemomente. Grundriss

Tabelle 1. Dicke t einer statisch gleichwertigen Flachdecke in [cm] mit

$p = \text{Deckenaufstand in } [\text{kg}/\text{m}^2]$

$$L_m = \sqrt{L_x \cdot L_y \text{ in [m]}}$$

P L_m	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
4.00	11	13	16	18	19	21	22	24	25	26	27	28
4.25	11	14	17	19	21	22	24	25	27	28	29	30
4.50	12	16	18	20	22	24	25	27	28	30	31	32
4.75	13	17	19	22	24	25	27	29	30	32	33	34
5.00	14	18	21	23	25	27	29	30	32	33	35	36
5.25	15	19	22	24	27	29	30	32	34	35	37	38
5.50	16	20	23	26	28	30	32	34	36	37	39	40
5.75	17	21	25	27	30	32	34	36	38	39	41	42
6.00	19	23	26	29	31	34	36	38	40	41	43	44
6.25	20	24	27	30	33	35	37	40	41	43	45	47
6.50	21	25	29	32	35	37	39	41	43	45	47	49
6.75	22	27	30	33	36	39	41	43	45	47	49	51
7.00	23	28	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53
7.25	25	29	33	37	40	42	45	47	50	52	54	55
7.50	26	31	35	38	41	44	47	49	52	54	56	58
7.75	27	32	37	40	43	46	49	51	54	56	58	60
8.00	29	34	38	42	45	48	51	53	56	58	60	62
8.25	30	36	40	44	47	50	53	56	58	60	63	65
8.50	32	37	42	45	49	52	55	58	60	63	65	67
8.75	33	39	43	47	51	54	57	60	62	65	67	70
9.00	35	40	45	49	53	56	59	62	65	67	70	72
9.25	37	42	47	51	55	58	61	64	67	70	72	75
9.50	38	44	49	53	57	60	63	66	69	72	75	77
9.75	40	46	51	55	59	62	66	69	72	74	77	80
10.00	42	47	52	57	61	64	68	71	74	77	80	82
10.25	43	49	54	59	63	67	70	73	76	79	82	85
10.50	45	51	56	61	65	69	72	76	79	82	85	87
10.75	47	53	58	63	67	71	75	78	81	84	87	90
11.00	49	55	60	65	69	73	77	80	84	87	90	93
11.25	51	57	62	67	72	76	79	83	86	89	92	95
11.50	53	59	65	70	74	78	82	85	89	92	95	98
11.75	55	61	67	72	76	80	84	88	91	95	98	101

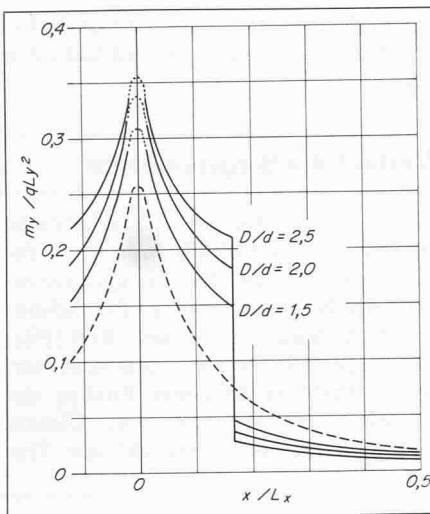


Bild 3. Querverteilung des Biegemomentes m_y in Stützenachse, Schnitt A-A. $L_y = L_x$
 — Flachpilzdecken
 - - - Flachdecke

richtung wird auch im «Näherungsverfahren» Rechnung getragen, indem das Biegemoment am Pilzrand sprunghweise verändert wird.

Die Diagramme (Bild 3-5) zeigen die Querverteilung der Biegemomente m_y für verschiedene Dickenverhältnisse einer Flachpilzdecke. Zum Vergleich sind die Momente einer Flachdecke sowie die vereinfachte Verteilung der Momente nach dem «Näherungsverfahren» ebenfalls eingetragen. Die angegebenen Werte gelten für ein Innenfeld einer gleichmäßig belasteten, unendlich ausgedehnten Decke auf quadratischem Stützenraster.

gung einer Einspannung der Stütze in der Decke [5]. Diese Annahme muss durch konstruktive Massnahmen erfüllt werden.

- Bei Einhaltung der Gleichgewichtsbedingungen können die Stützmomente durch Momentenumlagerung um maximal 15 Prozent abgemindert werden [6].

Schnitt 3-3, Plattenarmierung

Im Gegensatz zur Flachdecke ist in der Pilzdecke die Querverteilung der positiven Plattenmomente sehr gleichförmig. Aus diesem Grund darf die Plattenarmierung gleichmäßig verteilt eingelegt werden.

Schnitt 4-4, obere Pilzarmierung

Die Grösse der Stütze beeinflusst die Momentenspitze. Diese ist allerdings für das totale Biegemoment im Pilzbereich, M_{py} , und damit für die Bemessung von geringer Bedeutung.

Mit $D/d \approx 2,1 \div 2,5$ ist dieser Schnitt nie ausgenutzt. Die Biegearmierung für M_{py} nach dem «Näherungsverfahren» wird gleichmäßig über die Pilzbreite verteilt [4].

Schnitt 4-4, unterer Pilzrand

Der untere Pilzrand befindet sich infolge der negativen Plattenmomente unter Druck. Hier genügt eine sehr leichte konstruktive Armierung; allenfalls kann sogar darauf vollständig verzichtet werden.

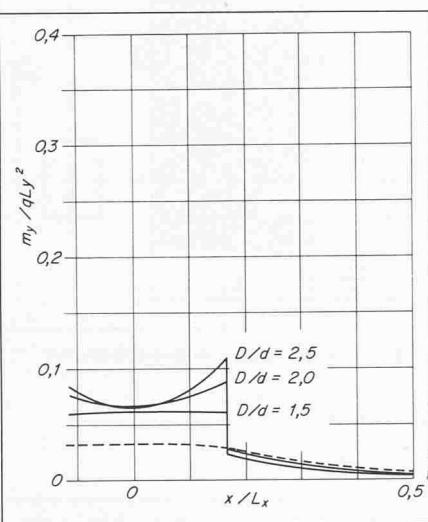


Bild 4. Querverteilung des Biegemomentes m_y am Pilzrand, Schnitt B-B. $L_y = L_x$
 — Flachpilzdecken
 - - - Flachdecke

Bemessung

Die Armierung der Pilzdecke wird mit den Bemessungsmomenten des «Näherungsverfahrens» bestimmt. Dabei ist zu beachten, dass

- die Decke in beiden Richtungen für die volle Last berechnet werden muss;
- die Haupttragrichtung in Richtung der längeren Spannweite ist;
- die planmässige Lage der Armierung (h) schon bei der Bemessung berücksichtigt wird.

Die kritischen Schnitte (Bild 6) sind die Schnitte 1-1 und 2-2:

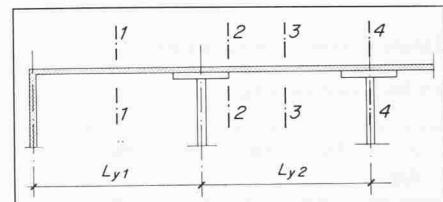


Bild 6. Bemessung. Bezeichnung der Schnitte

Schnitt 1-1

In langen Endfeldern, $L_{y1} \approx L_{y2}$, ist dieser Querschnitt voll ausgenutzt. Besonders bei Berücksichtigung von hohen Nutzlasten als Wechsellasten muss eventuell eine Verstärkung der Platte d in Betracht gezogen werden.

Schnitt 2-2

Bei Deckensystemen mit langen Endfeldern ist dieser Schnitt meist kritisch. Die Bemessung kann folgendermassen durchgeführt werden:

- Die untere Plattenarmierung ist als Druckarmierung zu berücksichtigen und entsprechend zu verankern.
- Die rechnerischen Betondruckspannungen am unteren Querschnittrand dürfen höher sein als die zulässigen, da sich der Schnitt unter Querdruck befindet. Die Spannungsspitzen in den Ecken des Pilzes werden durch Kriechen des Betons abgebaut.
- Das Stützmoment kann ev. etwas reduziert werden durch Berücksichti-

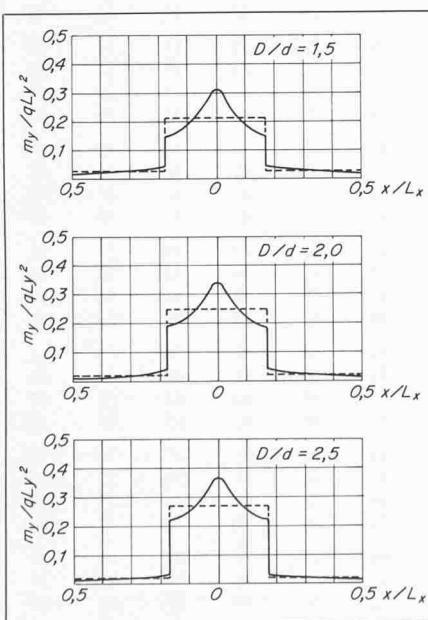


Bild 5. Querverteilung des Biegemomentes m_y in Stützenachse, Schnitt A-A. Vergleich mit dem «Näherungsverfahren». $L_y = L_x$
 — effektiver Momentverlauf
 - - - «Näherungsverfahren»

Armierungsschema

Die angegebenen Längen der Armierungsstäbe sind Richtwerte für ein Innenfeld einer mehrfeldrigen Flachpilzdecke mit gleichmäßig verteilten Lasten. Sie sollten statisch überprüft werden

- in Randfeldern,
- bei Berücksichtigung von hohen Nutzlasten als Wechsellasten,
- bei ungleichen Spannweiten in der Tragrichtung,
- bei Einzellasten.

Beim Nachweis der Zugkraftdeckung braucht keine Verschiebung der Momentenlinie in Rechnung gestellt zu werden (Bild 7).

Verschiedenes

Armierungsgehalt

Für gleichmäßig verteilte Vollast berechnete Flachpilzdecken mit $D/d \approx 2,1 \div 2,5$ weisen einen Armierungsgehalt auf von ca.

$$G_A = 70 \div 80 \text{ kg/m}^3 \text{ Beton.}$$

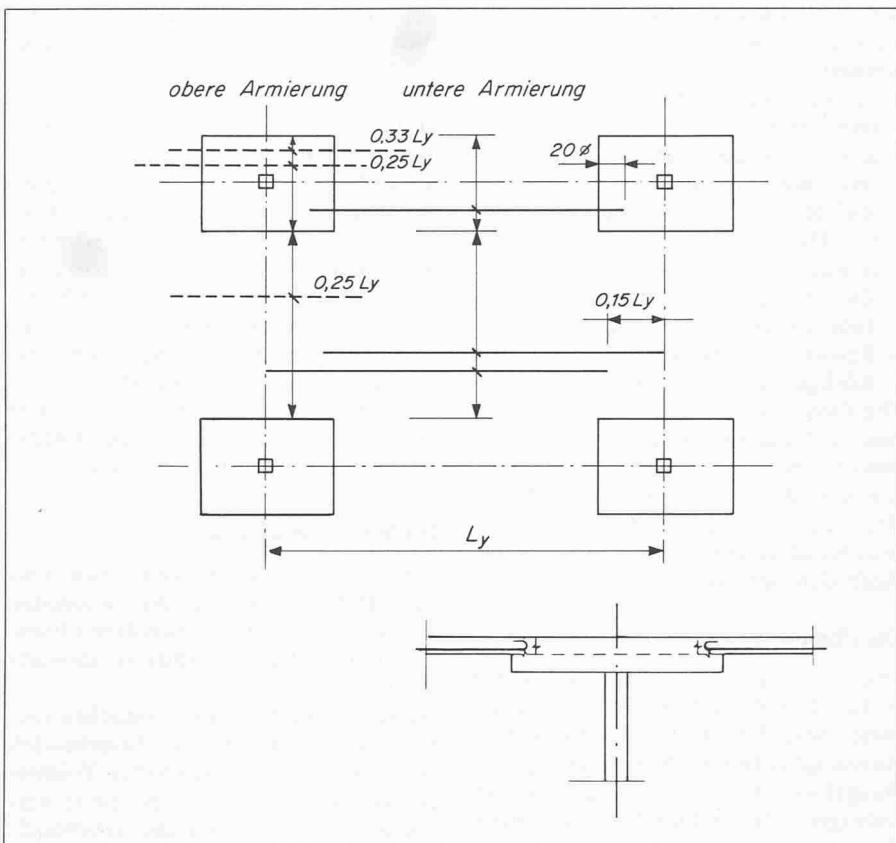


Bild 7. Armierungsschema. Grundriss (oben): Stablängen ab Systemachsen bzw. wie angegeben. (unten): Variante mit Arbeitsfuge beim Pilzrand

Werden hohe Nutzlasten als Wechsella-
sten berücksichtigt, steigt der Armie-
rungsgehalt bis auf ca.
 $G_A = 100 \text{ kg/m}^3$ Beton.

Werte über ca. 100 kg/m^3 sind Anlass
für eine sorgfältige Kontrolle der Ar-
mierung!

Durchstanzen

Flachpilzdecken sind auf Durchstanzen
der Stützen nach den Angaben der
Richtlinie Nr. 18 der Norm SIA 162,
1968, zu untersuchen.

Wasserdichtigkeit

Es ist unbedingt zu beachten, dass
Flachpilzdecken *nicht wasserdicht* her-
gestellt werden können, da sie in den
Pilzecken sehr hohe Spannungsspitzen
aufweisen. *Wasserdichtigkeit* kann bei
dieser Konstruktion *nur durch eine elas-
tische Isolation* gewährleistet werden.

Literatur

- [1] Die Bemessung von Flachpilzdecken, Näherungsverfahren. Emch + Berger Bern AG, Technische Mitteilungsblätter 1975. Schweiz. Bauzeitung, Heft 40, 1977
- [2] Flachpilzdecken: Dimensionierung, Bemessung und Konstruktion. Emch + Berger Bern AG, Technische Mitteilungsblätter 1976
- [3] Computerberechnungen (FEAPS) von Flachdecken und Pilzdecken. Emch + Berger Bern AG, 1973/74
- [4] R. Wagner, R. Harbord, H. Duddock: Flach- und Pilzdecken im ungerissen und im gerissen Zustand. Der Bauingenieur 50, 1975
- [5] Flachdeckenrahmen. Emch + Berger Bern AG, Interner Forschungsbericht, 1974
- [6] F. Leonhardt: Vorlesungen über Massivbau, 3. Teil 1974.

Adresse des Verfassers: H. B. Egli, dipl. Ing. ETH, Techdata AG, Gartenstr. 13, 3007 Bern

Energieplanung der Gemeinde

Von Luzius Huber, Zürich*)

Die Energiefrage trifft einen unserer wichtigsten Lebensnerven. Es ist nicht sicher, dass in den nächsten Jahren genügend neue oder verbesserte Technologien in der Erschliessung, Speicherung, Verteilung und sparsamen Verwendung gefunden werden. Wer weiss, ob die pessimistische Prognose, dass Energie immer teurer werde, stimmt, vielleicht lassen wir uns zu grossen Fehlinvestitionen verleiten, weil wir meinen, das Problem rasch bewältigen zu müssen.

Es führt zu einer grossen Verzerrung des Marktes, wenn wegen einer möglicherweise nur vorübergehenden Verknappung langfristig gewisse Primär-

energieformen und Versorgungssysteme technisch, gesetzlich oder finanziell zu sehr bevorzugt werden. Kommt es gar zu früh zu Anschlusszwängen an bestimmte Energieverteilnetze oder werden gar Perimeter für den langfristigen Ausbau solcher Netze verbindlich festgelegt, besteht die Gefahr, dass wir unsere Anpassungsfähigkeit vermindern und sich neuere, wirtschaftlich günstigere, umweltfreundlichere oder flexiblere Systeme erst viel später realisieren lassen. Die Energiekrise darf nicht dazu missbraucht werden, um Private und die Öffentlichkeit zu unüberlegten Ausgaben zu verleiten. Die gemeinsame Angst vor der Verknappung und sinkendem Wohlstand fordert von unseren Landes- und den Kantonenregierungen Besonnenheit und Mut, sich nicht zu Massnahmen verlei-

ten zu lassen, die über einen grossen Zeitraum periodisch Geldmittel für noch nicht bewährte Technologien verschlingen. Es geht nicht an, wenn für ganze Gebiete neue noch nicht auf gesichertem Wissen und Erfahrung basierende technische Normen oder zusammenhängende Systeme durchgesetzt werden, die uns Architekten, Ingenieuren und anderen Unternehmen wohl Beschäftigung und Gewinn bringen, aber keine Gewähr bieten, dass langfristig eine sichere Investition geschaffen wird.

Viele der in den letzten Jahren im einzelnen bis ins Detail entwickelte Technologien sind noch nicht reif, zu kostengünstiger und betriebssicherer Grossanlagen zusammengebaut zu werden. Um die Flexibilität zu bewahren und weitere Möglichkeiten offen zu halten, ist vorläufig mit begrenzten Investitionen, die in relativ kurzer Zeit abgeschrieben werden können, zu arbeiten. Den örtlichen Verhältnissen angepasste kleinräumigere Lösungen, bei denen verschiedene Energieformen alternativ

*) Überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten an der Tagung der Fachgruppe für Raumplanung und Umwelt: «Energieplanung, Aufgabe unserer Zeit», 9. Nov. 1979 in Bern